

Programmkomitee

U. Abelein, AUDI AG
W. Anheier, Universität Bremen
M. Brandstetter, Robert Bosch GmbH
O. Bringmann, FZI Karlsruhe
R. Brück, Universität Siegen
F. Dietz, Telefunken Semiconductors GmbH Co KG
S. Eichenberger, NXP Semiconductors Germany GmbH
P. Engelke, Infineon Technologies AG
R. Ernst, TU Braunschweig
M. Fischer, Verigy Germany GmbH
A. Garcia-Ortiz, Universität Bremen
G. Georgakos, Infineon Technologies AG
H. Gräß, TU München
C. Grimm, TU Wien
K. Hahn, Universität Siegen
T. Harriehausen, Ostfalia Hochschule
S. Hellebrand, Universität Paderborn
B. Hoppe, IBM Deutschland
T. Hötzel, Atmel Automotive GmbH
J. Kampe, Fachhochschule Jena
J. Kelber, Fachhochschule Schmalkalden
G. Kodl, Continental
R. Krämer, IHP GmbH
W. Kunz, Universität Kaiserslautern
J. Lienig, TU Dresden
B. Michel, Fraunhofer ENAS, Chemnitz
K. Müller-Glaser, Universität Karlsruhe
W. Nebel, OFFIS e.V., Oldenburg
F. Oppenheimer
S. Paul, Universität Bremen
R. Pferdenges, Infineon Technologies AG
F. Pöhl, Intel Mobile Communications GmbH
I. Polian, Universität Passau
M. Porrmann, Heinz-Nixdorf-Institut, Paderborn
M. Radetzki, Universität Stuttgart
M. Reuter, Mentor Graphics Deutschland GmbH
J. Rivoir, Verigy Germany GmbH
V. Schöber, edacentrum GmbH Hannover
F. Schenkel, MunEDA GmbH
C. Sebeke, Robert Bosch GmbH
R. Sommer, IMMS gGmbH
A. Steininger, TU Wien
J. Teich, Universität Erlangen-Nürnberg
R. Vahrman, Atmel Automotive GmbH
H. Vierhaus, BTU Cottbus
R. Wagner, Robert Bosch GmbH
B. Wittig, Volkswagen AG

Zuverlässigkeit und Entwurf

25. - 27. September 2012
Bremen

Tagungsleitung

Rolf Drechsler, DFKI und Universität Bremen

Vorsitzender des Programmkomitees

Görschwin Fey, DLR und Universität Bremen

Organisationskomitee

Jürgen Alt, Intel, München
Bernd Becker, Universität Freiburg
Oliver Bringmann, FZI, Karlsruhe
Manfred Dietrich, FhG-IIS / EAS, Dresden
Kai Hahn, Universität Siegen
Lars Hedrich, Universität Frankfurt/Main
Andreas Herkersdorf, TU München
Sebastian Sattler, Universität Erlangen-Nürnberg
Volker Schanz, VDE/ITG, Frankfurt/Main
Ulf Schlichtmann, TU München
Jürgen Schlöffel, Mentor Graphics, Hamburg
Ronald Schnabel, VDE/VDI-GMM, Frankfurt/Main
Klaus Schneider, TU Kaiserslautern
Hans-Joachim Wunderlich, Universität Stuttgart

Informationen zur Tagung

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik (GMM)
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69-6308-227
Fax +49 (0)69-6308-9828
E-Mail: zue2012@informatik.uni-bremen.de
<http://www.zue2012.de>

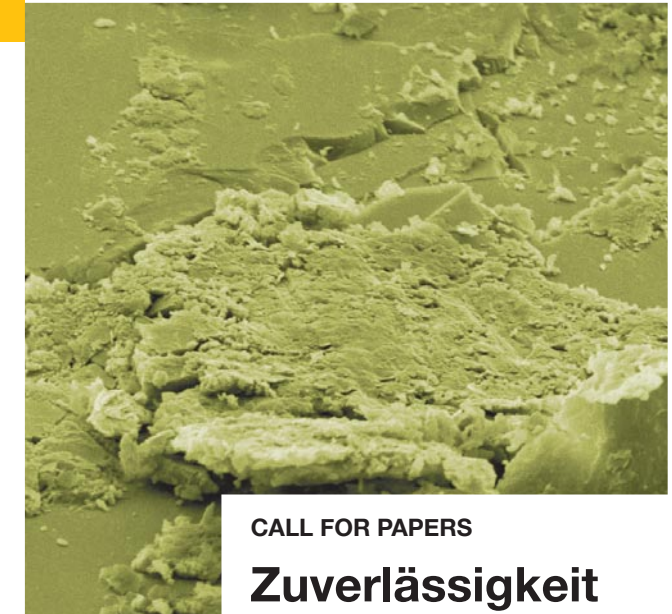
Copyright des Titelbilds: IIF / IMTEK / Universität Freiburg

GMM

VDE/VDI-GESELLSCHAFT
MIKROELEKTRONIK, MIKROSYSTEM-
UND FEINWERKTECHNIK

ITG

INFORMATIONSTECHNISCHE
GESELLSCHAFT IM VDE



CALL FOR PAPERS

Zuverlässigkeit und Entwurf

6. GMM/GI/ITG-Fachtagung

25. - 27. September 2012
Bremen

www.ZuE2012.de



Zuverlässigkeit und Entwurf

Die Fachtagung „Zuverlässigkeit und Entwurf“ (ZuE) wird 2012 in Bremen mit Unterstützung der Kooperationsgemeinschaft Rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf (RSS) der GI/GMM/ITG durchgeführt.

Eingebettete Systeme und *Cyber Physical Systems*, die direkt mit der Umwelt interagieren, sind allgegenwärtig. Mikroelektronik definiert dabei die wesentliche Funktionalität. Deshalb muss die Zuverlässigkeit des Systems sichergestellt werden, wobei der Begriff Zuverlässigkeit hier Korrektheit des Verhaltens, Robustheit gegenüber Ausnahmesituationen und lange Lebensdauern umfasst. Dies setzt eine durchgehende Berücksichtigung aller Schritte vom Entwurf bis zum Ende des Betriebes voraus.

Wirtschaftliche Aspekte wie *Qualitätssicherung*, *Produkthaftung* oder *time-to-market* sowie technische Aspekte wie *Parametervariationen* während der Produktion, komplexe *System-on-Chip-Entwürfe* oder *analog/mixed-signal* haben einen direkten Einfluss auf Entwurfsentscheidungen.

Deshalb besteht dringender Bedarf alle diese Randbedingungen durch innovative Verfahren beherrschbar zu machen.

Zu diesen Themen und verwandten Bereichen laden wir ein, wissenschaftliche Beiträge aus Theorie und industrieller Praxis einzureichen. Die Einsendungen werden einer umfassenden Begutachtung unterzogen und die angenommenen Artikel in einem Tagungsband veröffentlicht.

Rolf Drechsler und Görschwin Fey

Themenbereiche

- **Entwurfsmethodik**
 - Robuster Entwurf
 - Synthesis for Reliability and Yield
- **Eingebettete Systeme**
 - Systemzuverlässigkeit beim Hardware/Software Co-Entwurf
 - Verfügbarkeitsgarantien bei Degradation
- **Analoge Schaltungen**
 - Robuster Entwurf
 - Modellierung von Ausfalleffekten
- **Verifikation digitaler Systeme**
 - Korrektheit
 - Nachweis von Fehlertoleranz und Zuverlässigkeitseigenschaften
- **Beschreibungssprachen und Modellierung**
 - Multi-Domain-Systeme
 - Modellierung von Fehlertoleranz und Zuverlässigkeit
- **Layoutentwurf**
 - Methoden für den 3D-Layoutentwurf
 - Fertigungsgerechter und fertigungsnaher Entwurf (DfM, DfY)
- **Testmethoden und Diagnose**
 - Defekt- und Fehleranalyse
 - Test, Diagnose und Fehlertoleranz

Termine

13.04.2012
Einreichung der Beiträge

30.06.2012
Benachrichtigung der Autoren

Tagungsort

Bremen

Beiträge

Es sind Vorträge von ca. 20 Minuten Dauer mit anschließender Diskussion sowie Poster vorgesehen. Die angenommenen Beiträge werden in einem zitierfähigen Tagungsband mit CD-ROM zusammengefasst.

Die Fachtagung findet in deutscher Sprache statt, es sind jedoch englischsprachige Beiträge und Vorträge willkommen. Die Beiträge sollten bis zu 8 Seiten umfassen. Es wird eine Möglichkeit zur elektronischen Einreichung geschaffen.

Nähere Informationen unter:
www.ZuE2012.de